

Hirata

平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2024年11月

決算説明資料

2024年度(2025年3月期)
第2四半期

目次

I. 2024年度 第2四半期業績（連結）

II. 2024年度 通期業績予想（連結）

III. 株主還元について

IV. 参考資料

会社概要

会 社 名	平田機工株式会社 (英文表記:HIRATA Corporation)
所 在 地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長執行役員 平田 雄一郎
設 立	1951年12月29日
資 本 金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード 6258）
従 業 員	連結 2,432名 単体 1,535名 ※2024年9月30日現在
事 業 所	国内7拠点(熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都)
関係会社	国内3社（熊本県2社、東京都） 海外9社（アメリカ、メキシコ、ドイツ、シンガポール、タイ、マレーシア、中国2社・台湾）

I . 2024年度 第2四半期業績（連結）

業績概要

※第2四半期累計

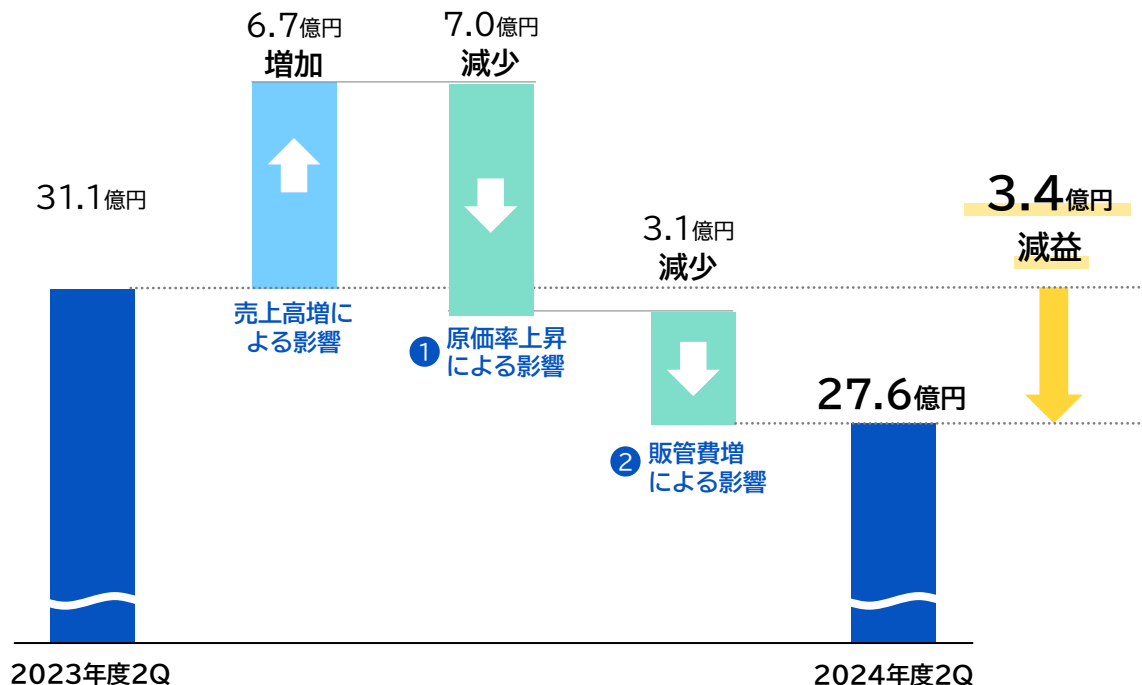
- **受注高** 対前年同期で増。自動車関連で複数の大型案件を受注。半導体関連は2Qに入り回復基調
- **売上高** 対前年同期で増。自動車を中心に受注済案件の生産が進捗
- **営業利益** 対前年同期で減。従来4Qに計上していた一部費用を前倒しで計上。また1Qにおける一部案件の原価率悪化が影響

(単位：百万円)

	2023年度2Q	2024年度2Q	対前年同期	
	実績	実績	増減額	増減率
受注高	42,724	43,975	1,250	2.9%
売上高	37,394	40,365	2,970	7.9%
営業利益 (利益率)	3,111 (8.3%)	2,765 (6.8%)	▲346	▲11.1%
経常利益	3,281	2,708	▲572	▲17.5%
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,303	1,803	▲499	▲21.7%
受注残高	67,334	69,014	1,679	2.5%

営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前年同期で**3.4億円減**
 - **主な増加要因**：売上高の増加
 - **主な減少要因**：一部案件での原価率上昇や販管費の増加等



① 原価率上昇による影響

原価率 77.4% ⇒ 79.1%

原価率上昇の主な要因

- ・従来4Qに計上していた賞与引当金の一部前倒し計上（人件費）
- ・賃上げ・人員増による人件費増
- ・一部案件の開発要素が想定を上回る
- ・減価償却費増

② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- ・従来4Qに計上していた賞与引当金の一部前倒し計上（人件費）
- ・賃上げ・人員増による人件費増

セグメント別業績

(単位：百万円)		2023年度2Q	2024年度2Q	増減	増減率
受注高	合計	42,724	43,975	1,250	2.9%
	自動車	19,404	24,733	5,329	27.5%
	半導体	13,838	13,393	▲444	▲3.2%
	その他自動省力機器	8,091	4,724	▲3,367	▲41.6%
	その他	1,390	1,123	▲266	▲19.2%
売上高	合計	37,394	40,365	2,970	7.9%
	自動車	16,585	18,895	2,309	13.9%
	半導体	13,431	14,174	742	5.5%
	その他自動省力機器	6,268	6,186	▲81	▲1.3%
	その他	1,109	1,109	0	0.0%
営業利益	合計	3,111	2,765	▲346	▲11.1%
	自動車	1,014	1,298	284	28.0%
	半導体	2,240	1,801	▲438	▲19.6%
	その他自動省力機器	▲106	▲308	▲202	-
	その他（消去含む）	▲36	▲26	9	-
受注残高	合計	67,334	69,014	1,679	2.5%
	自動車	34,460	44,988	10,528	30.6%
	半導体	22,160	18,689	▲3,470	▲15.7%
	その他自動省力機器	9,844	4,833	▲5,011	▲50.9%
	その他	869	502	▲366	▲42.2%

セグメント別業績：自動車関連

- 受注高は対前年同期で増。EV市場全体としては成長鈍化が見られるものの、EV向けバッテリー充放電関連設備やEDU組立ラインの大型案件を受注
- 売上高は対前年同期で増。前期受注済のEV関連案件（主にEDUやバッテリー関連等）および内燃機関案件の生産が進捗
- 営業利益は対前年同期で増。一部費用の計上時期変更（4Q→2Q）が営業利益を押し下げても、増収効果が上回り増益

（単位：百万円）

		2023年度2Q		2024年度2Q		対前年同期	
		実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高		19,404	-	24,733	-	5,329	27.5%
	EV	15,606	80.4%	18,690	75.6%	3,084	19.8%
	その他	3,797	19.6%	6,042	24.4%	2,245	59.1%
売上高		16,585	-	18,895	-	2,309	13.9%
	EV	12,869	77.6%	12,794	67.7%	▲74	▲0.6%
	その他	3,716	22.4%	6,100	32.3%	2,384	64.2%
受注残高		34,460	-	44,988	-	10,528	30.6%
営業利益		1,014	-	1,298	-	284	28.0%
営業利益率		6.1%	-	6.9%	-	-	-

セグメント別業績：半導体関連

- 受注高は前年同期並。ウェーハ搬送以外の受注は前年同期を下回るも、2Qに入りウェーハ搬送関連は回復基調
- 売上高は対前年同期で増。受注増を受け、ウェーハ搬送の生産が進捗
- 営業利益は対前年同期で減。高利益率案件が減少したことに加え、一部費用の計上時期変更(4Q→2Q)が営業利益を押し下げ

(単位：百万円)

		2023年度2Q		2024年度2Q		対前年同期	
		実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高		13,838	-	13,393	-	▲444	▲3.2%
	ウェーハ搬送	8,668	62.6%	11,046	82.5%	2,378	27.4%
	その他	5,169	37.4%	2,346	17.5%	▲2,823	▲54.6%
売上高		13,431	-	14,174	-	742	5.5%
	ウェーハ搬送	7,857	58.5%	9,871	69.6%	2,014	25.6%
	その他	5,574	41.5%	4,302	30.4%	▲1,271	▲22.8%
受注残高		22,160	-	18,689	-	▲3,470	▲15.7%
営業利益		2,240	-	1,801	-	▲438	▲19.6%
営業利益率		16.7%	-	12.7%	-	-	-

セグメント別業績：その他自動省力機器

- 受注高は対前年同期で減。有機EL・家電関連の受注に支えられた前年同期を下回る。顧客の設備投資の延期等も影響
- 売上高は前年同期並。受注済案件の生産が進捗するも、顧客の投資延期等が影響し低調に推移
- 営業利益は対前年同期で減。一部案件の原価率が悪化したことに加え、一部費用の計上時期変更(4Q→2Q)が営業利益を押し下げ

（単位：百万円）

	2023年度2Q		2024年度2Q		対前年同期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	8,091	-	4,724	-	▲3,367	▲41.6%
売上高	6,268	-	6,186	-	▲81	▲1.3%
受注残高	9,844	-	4,833	-	▲5,011	▲50.9%
営業利益	▲106	-	▲308	-	▲202	-
営業利益率	▲1.7%	-	▲5.0%	-	-	-

貸借対照表

（単位：百万円）

資産	2023年度	2024年度2Q	増減
流動資産	88,554	85,556	▲2,997
現金及び預金	10,652	8,456	▲2,196
売上債権等	59,504	60,425	920
棚卸資産	14,264	14,484	219
その他	4,131	2,190	▲1,941
固定資産	42,233	42,284	51
有形固定資産	27,437	26,954	▲483
無形固定資産	904	1,038	133
投資その他の資産	13,891	14,291	400
資産合計	130,787	127,841	▲2,946

負債	2023年度	2024年度2Q	増減
流動負債	49,864	42,040	▲7,823
固定負債	15,621	18,723	3,102
負債合計	65,485	60,764	▲4,721

純資産			
純資産合計	65,302	67,077	1,775

主な増減要因

- ・現金及び預金：工場増設費や買掛金の支払が進み減少
- ・流動負債：工場増設費や賞与の支払により未払金・未払費用が減少
短期借入金を一部返済し減少
- ・固定負債：大型案件や長納期案件増により長期借入金が増加

Ⅱ. 2024年度 通期業績予想（連結）

通期業績予想

● 売上高 1,000億円、営業利益 75億円の増収増益見通し ※2023年度決算発表時（2024年5月10日）より変更はございません

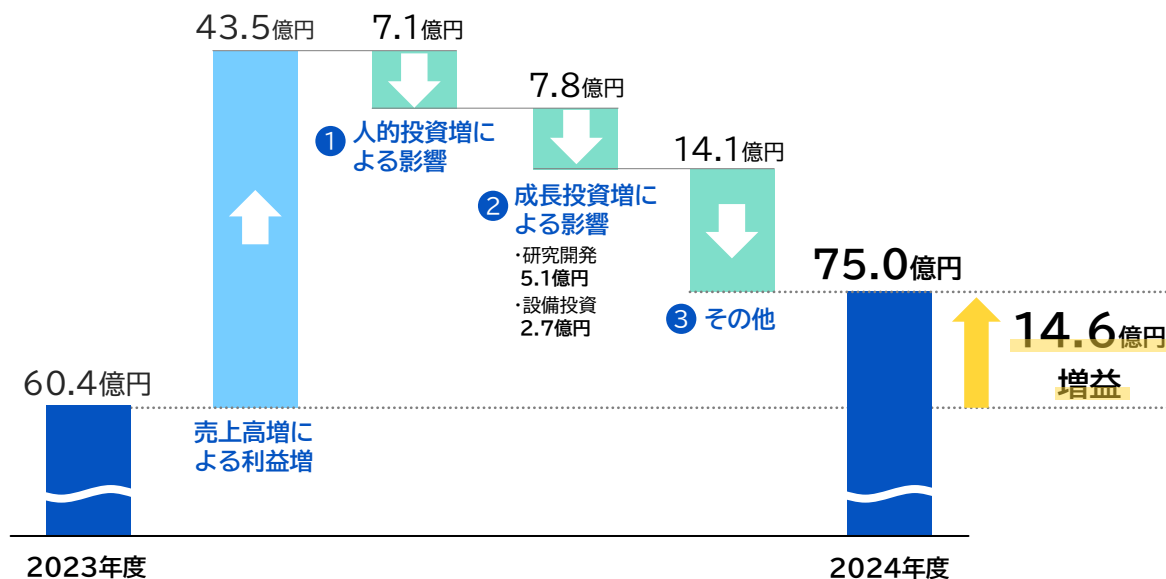
（単位：百万円）

	2023年度	2024年度	対前期	
	実績	通期予想	増減額	増減率
売上高	82,839	100,000	17,160	20.7%
自動車関連	36,984	50,000	13,015	35.2%
半導体関連	27,390	29,000	1,609	5.9%
その他自動省力機器	16,083	19,000	2,916	18.1%
その他	2,381	2,000	△381	△16.0%
営業利益（率）	6,047（7.3%）	7,500（7.5%）	1,452	24.0%
経常利益（率）	6,259（7.6%）	7,300（7.3%）	1,040	16.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益（率）	4,344（5.2%）	4,700（4.7%）	355	8.2%

通期業績予想のポイント（営業利益）

- 次の成長に向けた「収益性強化」「経営基盤強化」を実現するために人的投資や成長投資を積極的に実施
- 営業利益は対前期で増益となる見通し ※2023年度決算発表時（2024年5月10日）より変更はございません

主な対前期増減要因



① 人的投資 7.1億円

- ・将来の事業拡大を見据えた採用増
- ・物価高騰への対応、安定的な人材獲得を目的とした賃金増 等

② 成長投資 7.8億円

- ・既存事業における次世代製品開発の加速
- ・生産性向上に向けた設備投資 等

③ その他 14.1億円

- ・売上拡大に伴う販管費等の増
- ・調達コストの増 等

※影響額：対前年増減額（2023年度通期実績と比較した2024年度通期の増減予想額）

通期業績予想に対する進捗状況

- 2Qを終えた時点で、通期業績予想に対する進捗率は売上高で約40%、営業利益で約37%

	2023年度	2024年度2Q	2024年度	(単位：百万円)
	実績	実績	通期予想	予想に対する進捗率
売上高	82,839	40,365	100,000	40.4%
自動車関連	36,984	18,895	50,000	37.8%
半導体関連	27,390	14,174	29,000	48.9%
その他自動省力機器	16,083	6,186	19,000	32.6%
その他	2,381	1,109	2,000	55.5%
営業利益（率）	6,047(7.3%)	2,765(6.8%)	7,500(7.5%)	36.9%

- 顧客の投資延期等の影響を受け売上・営業利益ともに2Qまでの進捗が遅れるも、下期での挽回により通期予想は達成の見通し
- 下期の生産負荷が高まるが、期中の設備投資・人的投資により生産能力は向上。不足分については外部リソースも活用
- 下期は高い増収効果に加え、新規性が高く開発要素の多い（＝原価率が高い）案件が減ることで利益率の改善が見込まれる

Ⅲ. 株主還元について

1株当たり配当金・配当性向 推移および予想

(単位：円)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 予想
1株当たり配当金	40.00	65.00	65.00	90.00	100.00	120.00
配当性向 (%)	23.8	16.6	25.2	21.9	23.9	26.5

※配当性向は連結ベースです。

<配当に対する考え方>

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開などを勘案しながら、連結配当性向20%以上を概ねの目安とし、安定的・継続的に行うよう努めております。

今期の配当につきましては、期末配当として120円を予想しております。

なお、今後の配当に対する考え方につきましては、株主還元策も含めた資本政策の中で検討を進めてまいります。

自己株式の取得

- 資本効率の向上および株主への利益還元ならびに経営環境の変化などに応じた資本政策の柔軟性・機動性の確保を図り、自己株式の取得を行います

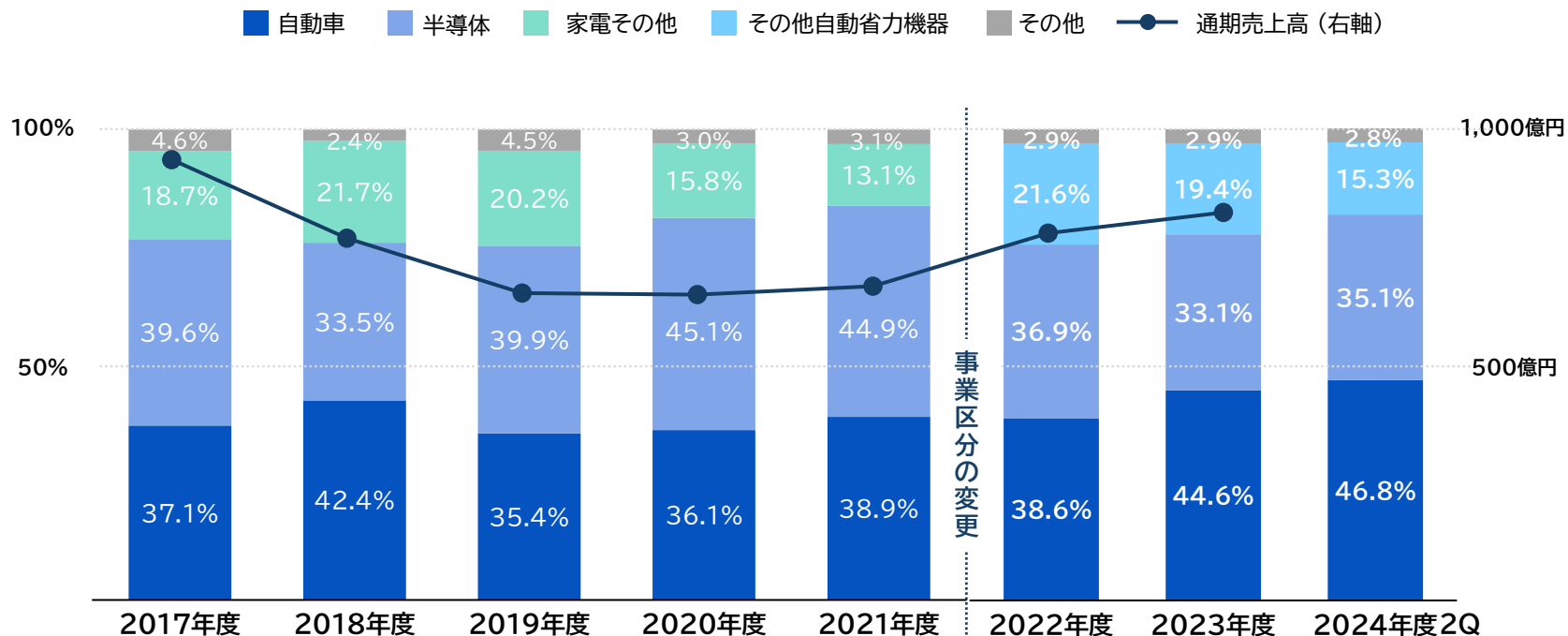
重要事項	内容
取得対象株式の種類	当社普通株式
取得し得る株式の総数	25万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.4%)
株式の取得価額の総額	10億円(上限)
取得期間	2024年11月11日から2025年3月31日

(ご参考)2024年9月30日時点の自己株式の保有状況

・発行済株式総数(自己株式を除く)	10,386,997株
・自己株式数(信託口含む)	369,093株

IV. 参考資料

セグメント別 売上高・構成比推移

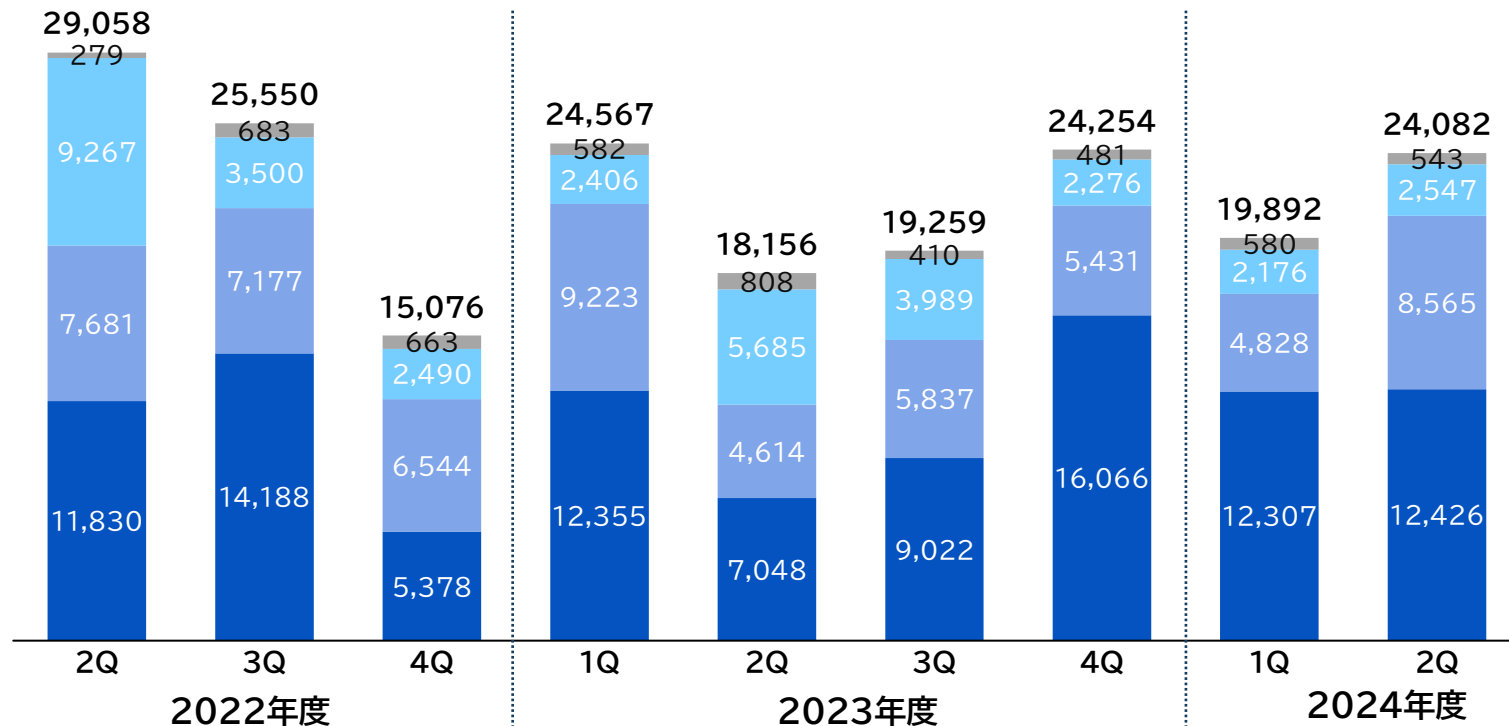


※2022年度より、事業区分の変更を行っております。

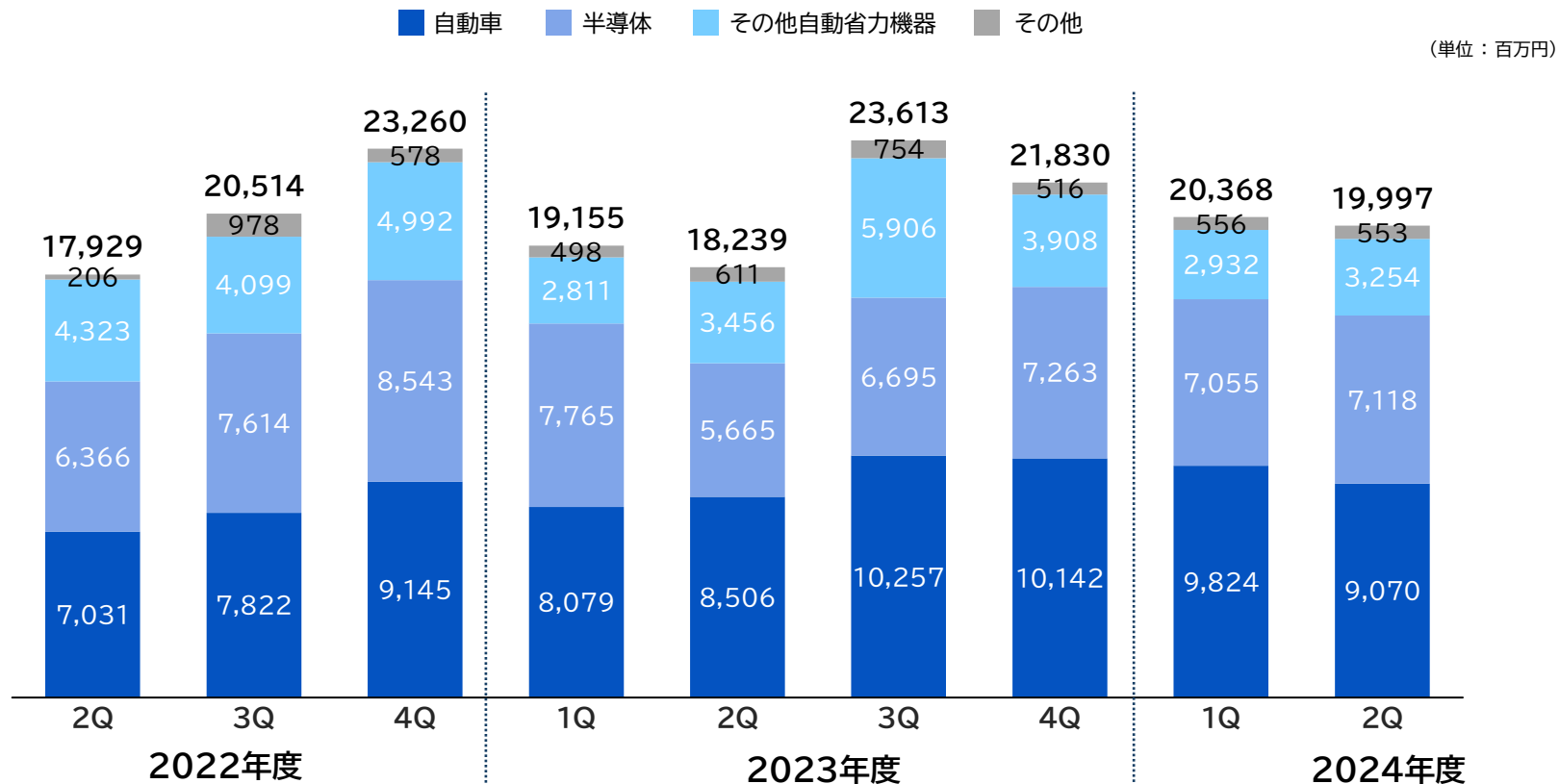
セグメント別 四半期推移【受注高】

■ 自動車 ■ 半導体 ■ その他自動車省力機器 ■ その他

(単位：百万円)

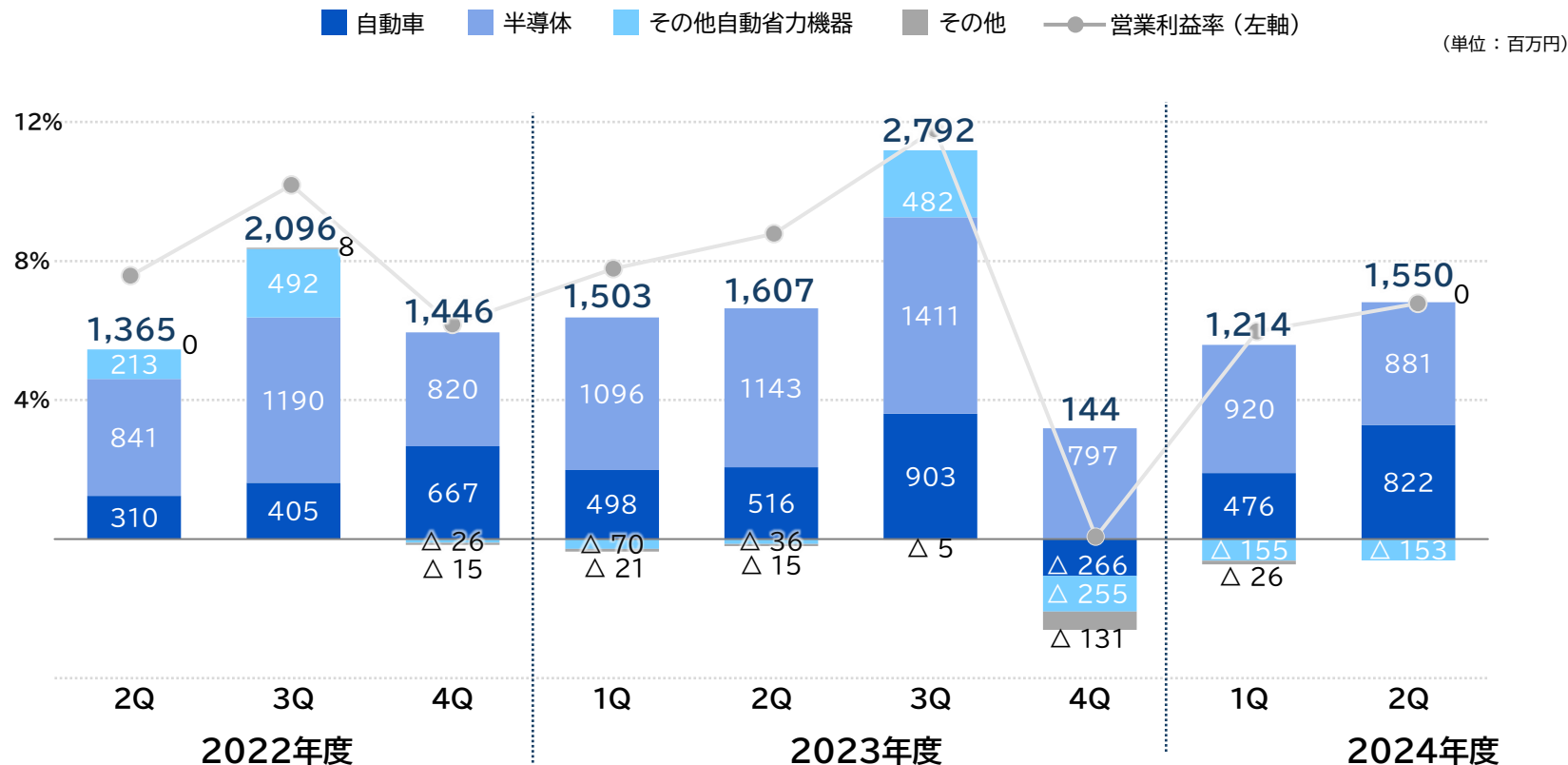


セグメント別 四半期推移【売上高】

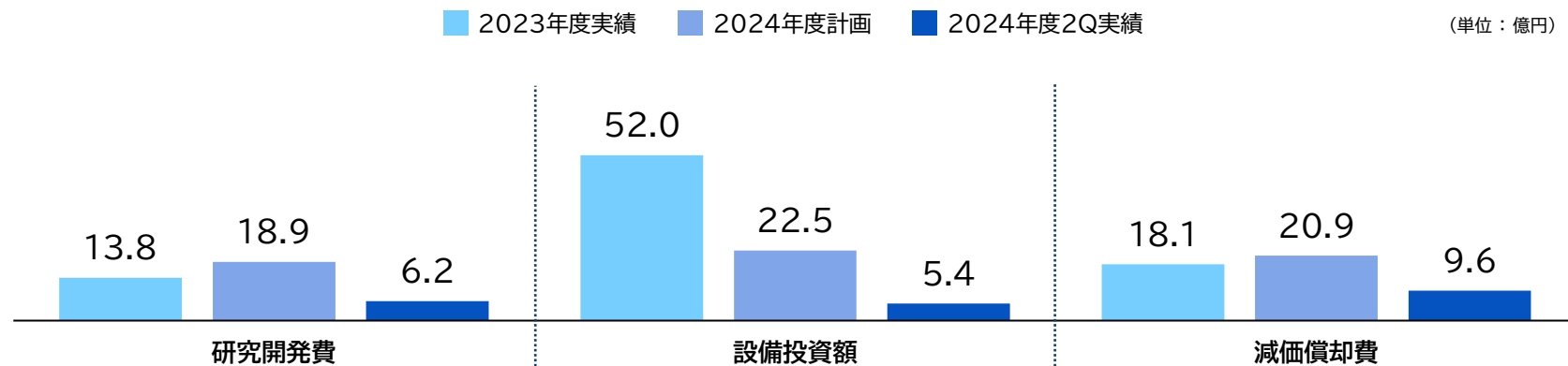


セグメント別 四半期推移【営業利益】

※その他に消去含む



研究開発費・設備投資額・減価償却費



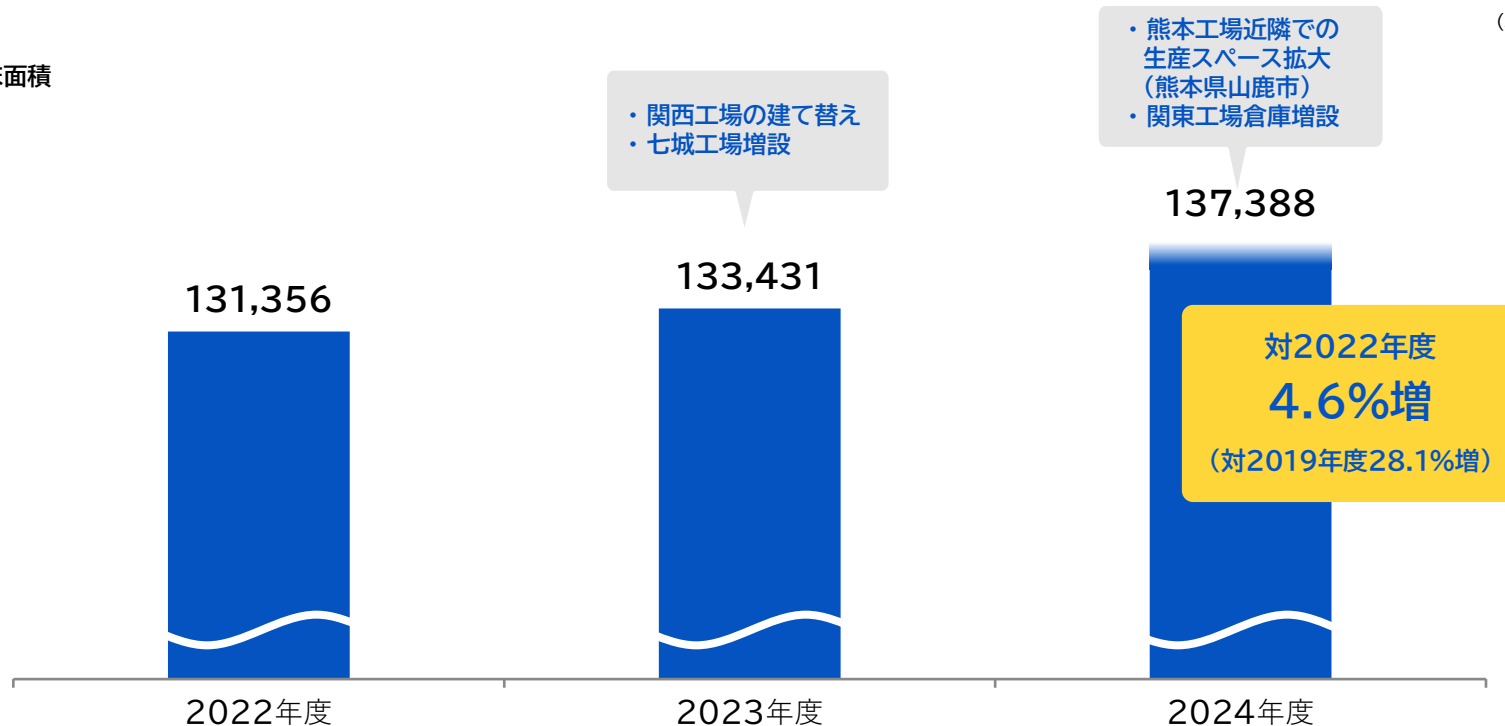
	主な投資内容	2023年度 実績	2024年度 計画	増減理由
研究開発費	既存事業における次世代製品開発	約 9.2	約 12.3	量産製品の開発を推進
	植物遺伝資源事業関連	約 4.5	約 6.6	減価償却費・人件費の増加
設備投資	工場の建替・増築	約 22.6	約 3.6	大規模な建替・増築は前年度までで一服
	植物遺伝資源事業関連	約 15.3	約 0.1	主要機材の導入が前年度で完了
	情報システム関連	約 2.1	約 1.8	次期基幹システム導入（前年度から継続）
	その他	約 12.0	約 17.1	生産性向上のための小口投資等の集積

生産スペース(単体・期末時点)

- 生産能力向上に向けた生産スペースの継続的な拡大に取り組んでいる
- 2024年度も熊本市に隣接する山鹿市に生産スペースを確保

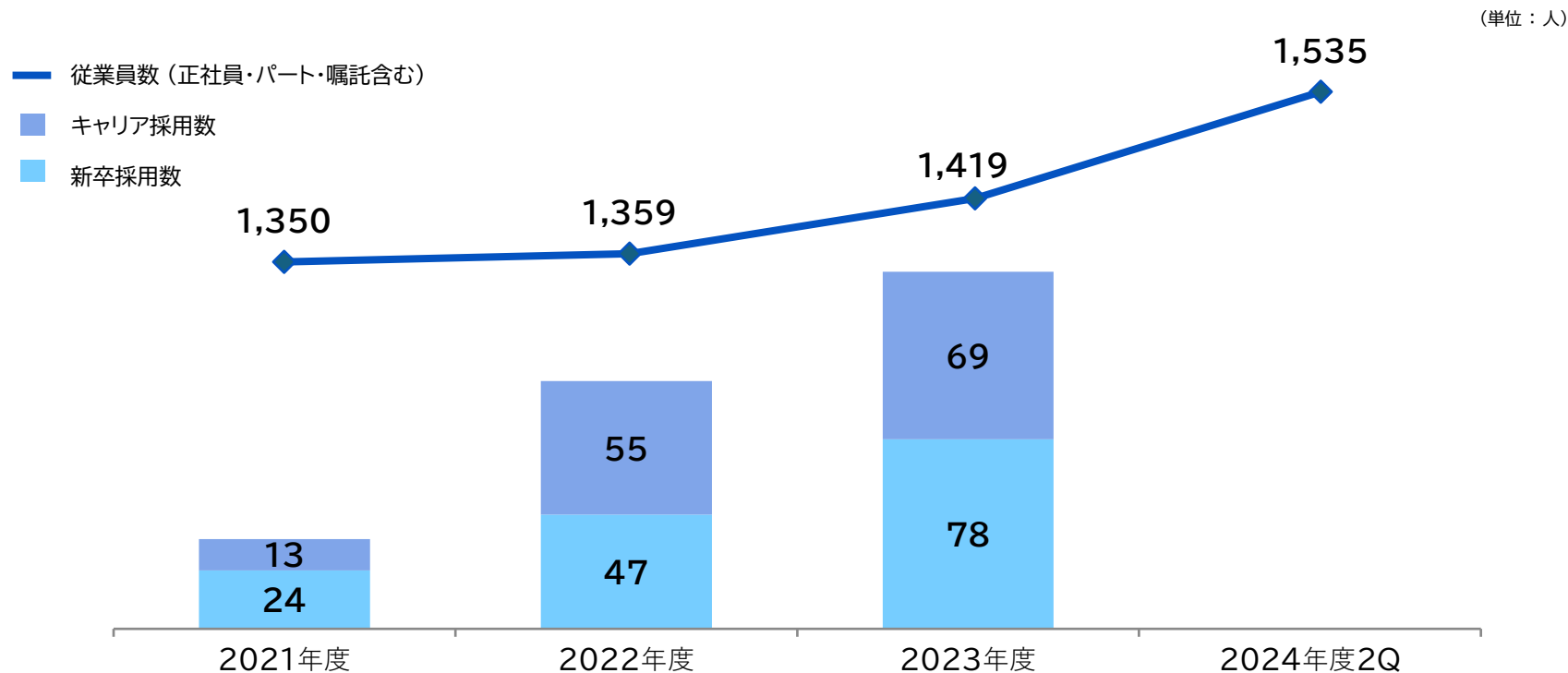
■ 延床面積

(単位：㎡)



採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む



想定される主な外部環境起因の機会／リスクと対応策

想定される 主な外部環境	想定する機会／リスク	主な対応策
為替（円安）	機会 ● 海外競合との相対的な価格競争力増 リスク ● 海外調達品の実質購入価格増	● 海外案件の積極的な受注拡大 ● 海外での現地生産の推進
米国大統領選	リスク ● EV市場動向を懸念した投資控え	● 顧客との緊密な情報交換による設備投資動向の把握 ● 対応領域拡大による新規顧客・案件確保 ● 主力事業の分散とリソース配分の適正化
新タイプバッテリーの量産化	機会 ● 技術開発と量産対応による商機拡大 リスク ● 開発要素負担による収益性悪化	● 顧客の研究開発段階から参画し、顧客要求に即した製品の開発・提案 ● 外部調達による開発費削減
生成AIの普及	機会 ● 半導体関連の需要増 リスク ● 生産能力・人的リソース不足による受注機会の損失	● 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 ● 半導体分野へのリソース投入 ＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資
熊本・九州への半導体 関連産業の集積	機会 ● 半導体関連の需要増 リスク ● 人材獲得競争の激化	● 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 ● 半導体分野へのリソース投入 ＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資 ● 積極的な人材採用 ● 社会動向も踏まえた賃金改定やリテンションの実施

トピックス：大型案件の受注

2023年度以降に開示した大型受注案件

事業部門	開示日		設備概要	金額
自動車関連	2023年	6月	EV向けドライブユニット組立設備	80億円超
	2024年	1月	EV向けバッテリー充放電関連設備	40億円超
		2月	内燃機関向けエンジン組立設備	約130億円
		5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約25億円
		8月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約56億円
		8月	EV向けドライブユニット組立設備	約87億円

- ・バッテリー充放電関連設備は2022年度より本格的な受注を開始し、受注実績は累計で150億円超
- ・大規模案件への対応力ならびにこれまでの納入実績等が評価され、継続して受注獲得

ESG経営の取り組み強化

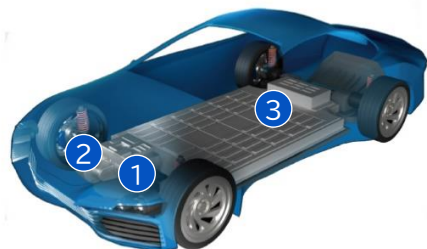
2022年	10月	「人権方針」策定、「調達基本方針」改定	
2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足 HPIに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化	 WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名	
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入	
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明	
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定 サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置	 FTSE Blossom Japan Index  FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定	

事業概要：自動車関連の主要製品

- EV関連を中心に、北米自動車メーカー（ビッグスリー）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注

EV関連の主力・拡大分野

当社が手掛ける生産設備



※完成製品イメージ

① EDU組立設備 主力分野

EDU (Electric Drive Unit) と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造



② IGBT・インバーター組立設備 主力分野

IGBTやインバーターといった、EVやトランスミッション車に搭載される車載用電子部品の組立設備を製造



③ バッテリー関連組立設備（セル充放電工程） 拡大分野

バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造



主要な地域・顧客・優位性

EDU組立設備

北米

顧客 ・ 北米自動車メーカー（ビッグスリー）
・ 北米新興EVメーカー

IGBT・インバーター組立設備

日本

顧客 国内車載用電子部品メーカー

バッテリー関連組立設備（充放電工程）

日本

顧客 国内バッテリーメーカー

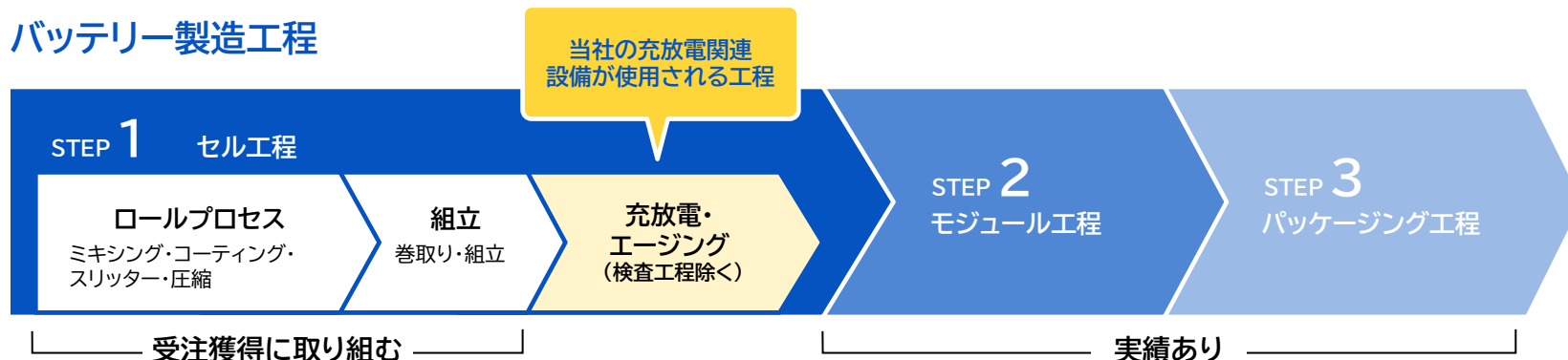
当社の競争優位性

- ・ 最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- ・ 顧客の生産ラインを一度自社工場内で構築し、生産能力・品質を検証した上で現地据え付け
- ・ 開発から生産・保守までの一貫体制
- ・ 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：充放電関連設備

- セル製造の最終工程である「充放電・エージング」を担う充放電関連設備
- 搬送・ストッカー技術を生かしたシステム化に当社優位性あり

バッテリー製造工程



当社の製品：充放電関連設備

- 組み立てられたセル（電池）に充放電を繰り返すことでセルを活性化させる（バッテリーとしての機能をもたせる）工程
- 当社で製造した搬送ラインや自動倉庫に、外部より調達した充放電機を組み込み、システムとして顧客に納品。
当社の搬送・ストッカー技術が差別化要因

搬送システム

工程間の最適搬送を行う

エージング用 倉庫システム

高温環境でのテストや自動倉庫に長期間収納放置し、一定期間後のセル電圧をパフォーマンス測定

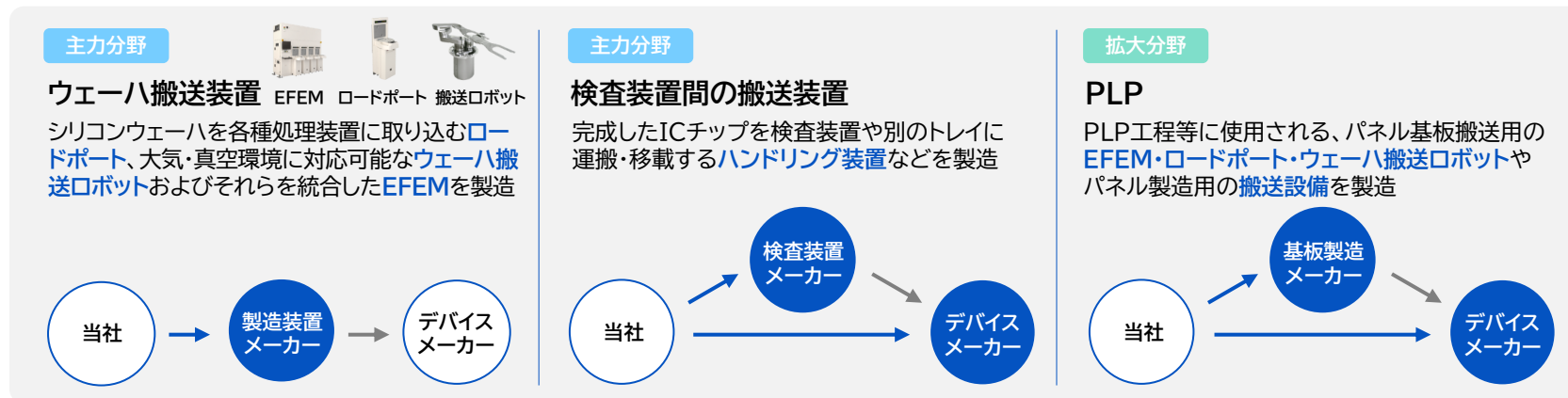
充放電用 倉庫システム

満充電と放電を数回繰り返す工程。充電容量、充電速度、繰り返し回数等によって数時間を要する

事業概要：半導体関連の主要製品

- 国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注

半導体関連の主力・拡大分野



主要な地域・顧客・優位性

ウェーハ搬送装置 日本 顧客 国内製造装置メーカー	検査装置間の搬送装置 北米・日本 顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内検査装置メーカー	PLP 北米・欧州・日本 顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内/欧州基板製造メーカー
---	---	--

当社の競争優位性

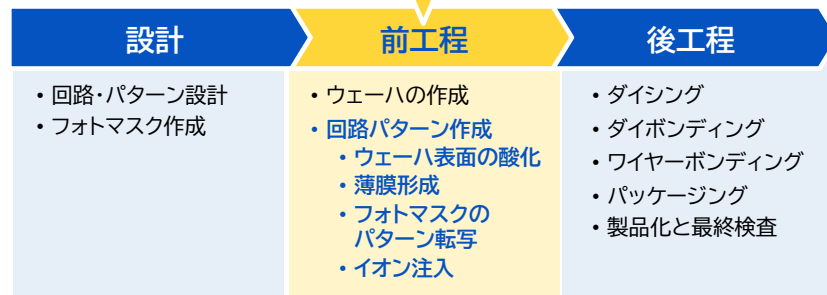
- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見・技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：ウェーハ搬送装置

- 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、ウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEMを設計・製造

半導体製造工程

当社ウェーハ搬送装置が
主に使用される工程



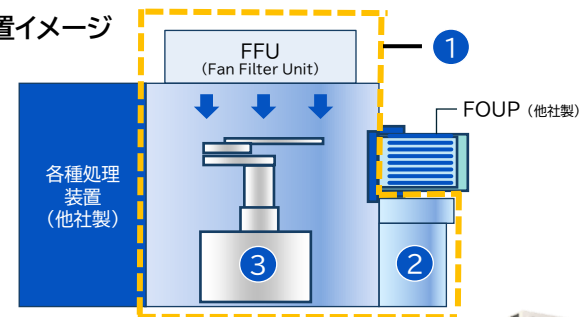
当社製品設置イメージ



処理装置ごとにEFEM・ロードポートが設置されるため1つのラインで複数のEFEM・ロードポートが用いられる

当社の主要製品

当社製品設置イメージ



- EFEM (Equipment Front End Module)**
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前面にロードポートが設置される。
- ロードポート**
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている
- ウェーハ搬送ロボット**
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている。

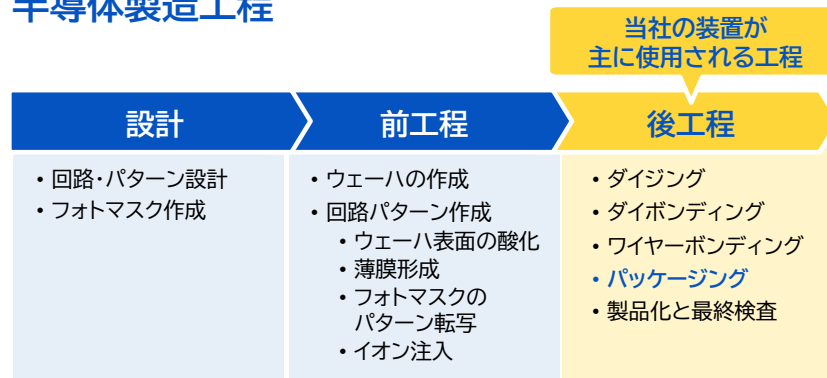
※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器



事業概要：PLP

- 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

半導体製造工程



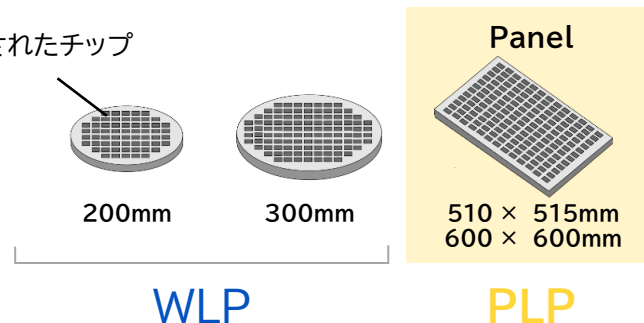
PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板上に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的に510×515mm角など、ウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用

パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
WLP (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 良品チップのみをウェーハに再配列 し、チップがウェーハ上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
PLP (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 良品チップのみを四角形のパネルに再配列 し、チップが パネル上にある状態 で基板に接着・封止し、個々に切り分ける

再配列されたチップ



事業概要：その他自動省力機器

- 有機ELの蒸着装置や家電メーカー向けの組立設備、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

その他自動省力機器の主力・新規分野

主力分野

医療理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

主力分野

家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモーターの組立設備をはじめあらゆる設備・装置を製造

有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

収益化に向けた新規分野

超音波ガイド下 集束超音波治療装置

- ・ すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス社（本社：東京都新宿区、以下ソニア社）と共同開発中
- ・ ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- ・ 人での臨床試験がスタートし、次なる量産用装置の開発に着手した

主要な地域・顧客・優位性

医療・理化学機器

日本

顧客 国内医療専門メーカー

家電メーカー向け 組立設備

アジア

顧客 アジア家電製造メーカー

有機EL用蒸着装置

日本

顧客 国内製造装置メーカー

当社の競争優位性

- ・ さまざまな分野の生産設備・装置に携わってきた豊富な知見とノウハウ
- ・ 開発から生産・保守までの一貫体制
- ・ 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：超音波ガイド下集束超音波治療装置

- 医療・理化学機器分野での検体検査自動化の経験とロボット技術を応用し「治療」領域へ進出

当社既存事業 平田機工バイオ機器部

「検体検査」の自動化技術



医療機器20年以上の実績
(クラスⅠ：一般医療機器)

新規パートナー ソニア社

臨床・治験・集束超音波技術

東京女子医科大学、東北大学、東京医科大学
で10年以上掛けて築き上げてきた技術

当社既存技術 平田機工ロボット事業部

ロボット技術

産業用ロボットの実績



新分野への進出

ソニア社にて治験を実施
当社は製造体制を構築

がん治療装置 共同開発

販売開始・量産を目指す
(クラスⅢ：高度管理医療機器)

- 医療・理化学機器分野において、ソニア・セラピューティクス株式会社(以下ソニア社)と提携
- 治験(人での臨床試験)用のがん治療装置の共同開発を実施(切除不能の膵がんが対象)
- 皮膚切開や臓器の切除を伴わない低侵襲な治療のための装置を開発
- 複数の国内病院に納入し、ソニア社にて国内治験を実施中。当社は納入後のアフターサービスを実施中
- 今後は装置の安全性、ユーザビリティ(使用性)、デザインなどをブラッシュアップし、量産装置の開発、量産体制の構築を目指す
- 海外展開を計画しており、海外病院への早期納入および当社海外拠点でのアフターサービスを目指す

本資料のお取り扱い上のご注意

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。